**Smarter Micro 2023届校园招聘**

**招聘流程：**

网申-宣讲-笔试-面试-offer-签约-入职

**01 简历投递：**

网投：[https://app.mokahr.com/campus-recruitment/smartermicro/56021#/](https://app.mokahr.com/campus-recruitment/smartermicro/56021%22%20%5Cl%20%22/)

微信群： 慧智微招聘网站

 

**02行程安排**

**线下行程（宣讲+笔试+面试）：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **城市** | **学校** | **宣讲时间** | **面试时间** |
| 成都 | 电子科技大学 | 2022/8/26 | 2022/8/27 |
| 西安 | 西安电子科技大学 | 2022/9/13 | 2022/9/14 |
| 西安交通大学 | 2022/9/14 | 2022/9/15 |
| 上海 | 大同学吧双选会 | 2022/8/28 | 笔试后待通知 |
| 广州 | 西安电子科技大学广州研究院 | 2022/8/30 | 笔试后待通知 |
| 南京 | 东南大学 | 2022/8/26 | 2022/8/27 |
| 合肥 | 中国科学技术大学 | 2022/9/23 | 2022/9/24 |
| 天津 | 天津大学 | 2022/9/7 | 2022/9/8 |
| 杭州 | 杭州电子科技大学 | 2022/9/7 | 2022/9/8 |
| 浙江大学 | 2022/9/8 | 2022/9/9 |
| 上海 | 上海交通大学 | 2022/9/15 | 笔试后待通知 |
| 武汉 | 华中科技大学 | 2022/9/15 | 2022/9/16 |
| 北京 | 清华大学 | 2022/9/17 | 2022/9/18 |
| 北京航空航天大学 | 2022/9/18 | 2022/9/19 |
| 广州 | 华南理工大学 | 2022/9/20（五山） | 笔试后待通知 |
| 中山大学 | 2022/9/21（大学城） | 笔试后待通知 |
| 广东工业大学 | 笔试后待通知 |
| 上海 | 复旦大学 | 2022/9/22 | 笔试后待通知 |

**线上行程：**

**8月25日：报名线上笔试**

笔试报名链接：<https://smartermicro.wjx.cn/vm/eG36V4w.aspx>

笔试简历网投：<https://app.mokahr.com/campus-recruitment/smartermicro/56021#/>

**校招岗位**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位名称** | **地区** | **学历要求** |
| 1 | 射频IC设计工程师 | 广州、上海 | 硕士/博士研究生 |
| 2 | 模拟IC设计工程师 | 广州、上海 | 硕士/博士研究生 |
| 3 | 数字IC设计工程师 | 广州、上海 | 硕士/博士研究生 |
| 4 | 射频无源设计工程师 | 广州、上海 | 硕士/博士研究生 |
| 5 | 研发测试工程师 | 广州、上海 | 本科 |
| 6 | 应用工程师 | 广州、上海、西安 | 本科 |
| 7 | 量产测试工程师 | 上海 | 本科 |
| 以上岗位专业要求：集成电路工程、微电子、电子信息与技术，微固电子、通信工程、物理学、自动化等相关专业，还需要弱电类其他相关专业，包括不限制：仪器科学，机械电子，航空航天，精密仪表、空天信息技术。 |

**职位详情：**

**射频IC设计工程师**

学历要求：硕士/博士研究生

工作地点：广州/上海

职责：

1、负责进行射频集成电路设计；

2、进行仿真、验证和评估；

3、指导版图工程师设计；

4、配合应用和产品工程师，测试工程师使产品成功进入量产。

要求:

1、电子工程及相关专业硕士；

2、掌握大信号设计流程和方法；

3、熟练使用Cadence、ADS等EDA设计工具；熟悉后端仿真验证；

4、熟练使用EM仿真工具；

5、熟练使用主要射频及微波测试仪器；

优先考虑：

1、有GaAs射频功率放大器、射频前端设计经验，有成功流片经验；

2、熟悉射频集成电路版图设计；

3、熟悉射频基板和封装设计；

4、熟悉射频系统PCB版图设计；

5、熟悉代工厂制造流程，有丰富的沟通经验；

**模拟IC设计工程师**

学历要求：硕士/博士研究生

工作地点：广州/上海

职责：

1、负责进行CMOS模拟集成电路设计；

2、进行仿真、验证和评估；

3、指导版图工程师设计；

4、配合应用和产品工程师、测试工程师使产品成功进入量产。

要求:

1、电子工程及相关专业硕士；

2、熟练掌握模拟电路设计流程和方法, 如运算放大器，电压基准源，滤波器等；

3、熟练使用Cadence等EDA设计工具；熟悉后端仿真验证 ；

优先考虑：

1、熟悉行为级和混合信号仿真设计，有成功流片经验；

2、熟悉模拟电路版图设计；

3、有ADC/DAC、DC-DC转换器、 或射频功率放大器、射频开关的控制器设计经验等；

4、熟悉代工厂制造流程，有丰富的沟通经验；

**数字IC设计工程师**

学历要求：硕士/博士研究生

工作地点：广州/上海

职责:

1、负责数字集成电路模块设计和版图规划；

2、参与产品功能定义；

3、算法分析和实现；

4、仿真、综合并验证电路的功能；

5、电路、芯片测试规划；

要求:

1、电子工程及相关专业硕士，或2年以上相关工作经验；

2、熟悉算法实现；

3、熟悉数字前后端设计流程；

4、熟练使用Cadence、Synopsys工具完成电路设计与仿真，版图设计与验证；

优先：

1、熟悉skill/tcl脚本、linux系统使用；

2、熟悉mipi接口协议，有相关项目经验

以上为参考要求，如特别合适的候选人，可酌情调准。

**射频无源设计工程师**

学历要求：硕士/博士研究生

工作地点：广州/上海

职责:

1、负责射频无源电路及器件的研究与设计；

2、进行仿真、验证和评估；

3、指导版图工程师设计；

4、配合产品及应用工程师，对无源电路及器件进行深入分析研究并量产应用；

要求：

1、电子、微波工程等相关专业专业硕士或2年以上相关工作经验，有成功流片经验；

2、掌握射频匹配网络及器件设计与EM仿真；

3、熟练使用Cadence、ADS等EDA设计工具；

4、熟练使用EM仿真工具，如HFSS、CST、COMSOL等；

5、熟练使用主要射频及微波测试仪器；

优先：

1、有IPD、声波滤波器、射频前端无源器件设计经验；

2、熟悉射频集成电路版图设计；

3、熟悉射频基板和封装设计；

4、熟悉射频系统PCB版图设计；

5、有电、热及应力多物理场耦合仿真设计经验；

6、熟悉代工厂制造流程，有丰富的沟通经验；

**研发测试工程师**

学历要求：本科

工作地点：广州/上海

职责：

1. 负责微波射频芯片和模块产品的的实验室组装、测试和调试；

2. 使用和维护实验室仪器设备，包括校准、搭建测试平台和校验；

3. 负责开发和维护实验室自动测试程序；

4. 研发测试相关资料的整理，归档和维护；

要求:

1、对RF电路有一定了解；

2、熟练使用射频测试仪器，如信号发生器、频谱仪、网络分析仪、功率计、示波器、电源等；

3、熟练使用C++,VB，C#,LABVIEW等一种编程语言。

4、工作态度端正、积极负责并具有良好的团队合作意识；

5、有一定英文阅读能力；

**射频应用工程师**

学历要求：本科

工作地点：广州/上海/西安

职责：

1、熟悉不同的手机平台，能独立完成相关的调试和测试，输出完整的测试报告；

2、能使用信号源，功率计，频谱仪等设备进行芯片Demo板进行测试；

3、对接公司内部研发部门，对新产品进行系统上的评估和验证，输出产品的应用指导文件；

4、对于产品在系统上的问题，能够对问题的本质给出准确的判断，和研发人员协同找出问题的根本原因；

5、系统指标分析，制定产品相关指标和测试方案；

要求：

1、本科及以上学历，无工作年限要求；

2、具有射频、微波、电路的背景知识；

3、熟练使用射频测试仪器，如信号发生器、频谱仪、网络分析仪、功率计、示波器、电源电压等；

4、对不同手机平台有一定的了解，有终端调试经验；

**量产测试工程师**

学历要求：本科

工作地点：上海

岗位要求:

1、根据产品手册，设计新产品量产测试方案（软硬件方案，确保产品测试开发和量产）

2.、完成新产品量产测试软硬件方案开发调试，并最终导入量产。

3、处理量产过程中的异常情况，保证产品量产顺利进行;

4、发现和找出量产测试方案存在的问题，提高量产测试的准确性和有效性。

5、追踪分析量产测试数据，产品低良分析和验证

6、测试时间优化，节省测试成本。

7、具备相当的沟通协调能力，能够进行公司内外部沟通协作。

经验要求：

1、重点本科及以上学历，电磁场工程与微波技术、电子工程和无线电等相关专业

2、熟悉电路原理，熟悉射频收发系统及功率放大器电路，熟悉C/C++或其他编程语言的基本原理，如果熟悉集成电路机台测试原理和各主流测试ATE的特点最好;

3、有独立的射频电路板调试能力，有相关的测试经验最好；

4、熟练使用射频测试仪器

5、具有较强的沟通能力，英文读写熟练；

6、有责任心，细致，严谨，有耐心

以上为参考要求，如特别合适的候选人，可酌情调准。

**公司简介**

慧智微是一家为智能手机、物联网等领域提供射频前端的芯片设计公司，主营业务为射频前端芯片及模组的研发、设计和销售。

公司具备全套射频前端芯片设计能力和集成化模组研发能力，技术体系以功率放大器（PA）的设计能力为核心，兼具低噪声放大器（LNA）、射频开关（Switch）、集成无源器件滤波器（IPD Filter）等射频器件的设计能力，产品系列覆盖的通信频段需求包括2G、3G、4G、3GHz以下的5G重耕频段、3GHz~6GHz的5G新频段等，可为客户提供无线通信射频前端发射模组、接收模组等，其产品应用于三星、OPPO、vivo、荣耀等国内外智能手机品牌机型，并进入闻泰科技、华勤通讯等一线移动终端设备ODM厂商和移远通信、广和通、日海智能等头部无线通信模组厂商。

自成立以来，公司专注于可重构射频前端架构，采用基于“绝缘硅（SOI）+砷化镓（GaAs）”两种材料体系的混合架构功率放大器技术路线，并实现技术突破及规模商用，使射频前端器件可以通过软件配置实现不同频段、模式、制式和场景下的复用，取得性能、成本、尺寸多方面优化，帮助客户化繁为简、与时俱进。

公司始终坚持以技术创新为核心竞争优势，通过内部培养和外部引进等方式打造了一支高素质的研发团队，技术范围覆盖芯片设计能力和集成化模组设计能力等方面，核心技术团队行业经验丰富，平均从业年限超过15年。公司注重人才培养，加强团队的内部培训和成长，打造浓厚的工程师文化，不断提升公司的竞争优势和可持续发展能力。

放眼未来，公司将不断引领射频创新，为客户提供满意的射频解决方案，共同构建更加智能的未来世界。

**发展历程**

技术平台开发（2011-2014）
2011年，慧智微正式成立，创立之初便致力于多频多模可重构的射频前端架构开发
2013年，成功开发可量产可重构射频前端技术平台AgiPAM®1.0

市场进入及渗透（2015-2018）
2015年，成功开发基于AgiPAM®1.0推出4G LTE多模多频可重构射频前端产品，并成功实现规模量产
2017年，第二代可重构架构AgiPAM®2.0研发成功，4G LTE MMMB PAM顺利量产
2018年，SOI产品联盟“SOI产业成就奖”

成长与突破期（2019-2022+）
2019年，公司自主研发的4G可重构射频前端芯片套片S5643-51产品荣获第十四届“中国芯”优秀市场表现产品奖
2020年，规模量产支持5G新频段的L-PAMiF射频前端模组，并在头部客户规模出货
2020年，第三代可重构架构AgiPAM®3.0研发成功，推出5G重耕频段MMMB PAM产品
2020年，公司自主研发的全集成5G新频段射频前端收发模组（L-PAMiF）/S55255产品荣获第十五届“中国芯”年度重大创新突破产品
2021年，公司自主研发的高集成度5G n77/78射频前端收发模组/S55217产品荣获第十六届“中国芯”优秀技术创新产品
2021年，公司荣获中国通信学会科学技术一等奖

**二维码**

公司公众号



**人才福利**

带薪年假，五险一金，补充商业保险，旅游团建，

运动健身， 缤纷下午茶， 年度体检，节日福利， 生育津贴

**公司地址**

广州总部

广州经济技术开发区科学城科学大道182号创新大厦

上海分部

上海浦东新区郭守敬路498号浦东软件园

深圳分部

深圳市南山区科技园中区科苑路科兴科学园

西安分部

西安市雁塔区唐延南路8号泰维智链中心